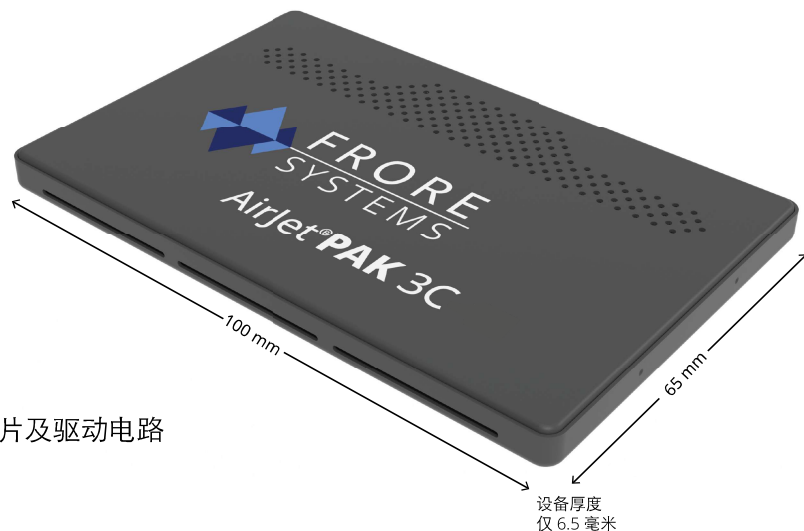




AirJet® PAK 3C

专为 NVIDIA Jetson Orin Nano/NX 设计，
旨在释放极致 AI 性能。

- 全集成、即插即用型散热解决方案，内置多颗 AirJet 芯片及驱动电路
- 直接安装于 NVIDIA Jetson Orin Nano/NX 模组之上
- 自主运行
- 超薄、静音、无振动、防尘且防溅水
- 助力 NVIDIA Jetson 实现高达 80 TOPS 的算力
- 在 25°C 环境温度、结温 (Tj) 为 115°C 时，净散热功耗可达 24W



散热是计算领域最大的瓶颈，但散热却是现代计算中唯一仍沿用百年前技术的环节。AI 所需的大规模运算对散热性能的要求正快速提升，而据预测，到 2030 年边缘 AI 的需求将增长 300% 以上，这一趋势短期内不会放缓。

AirJet PAK 是全球首款面向边缘 AI 的固态主动散热方案，其核心是革命性的 AirJet 主动散热芯片。**AirJet PAK 3C** 是一款完全独立的主动散热模块。

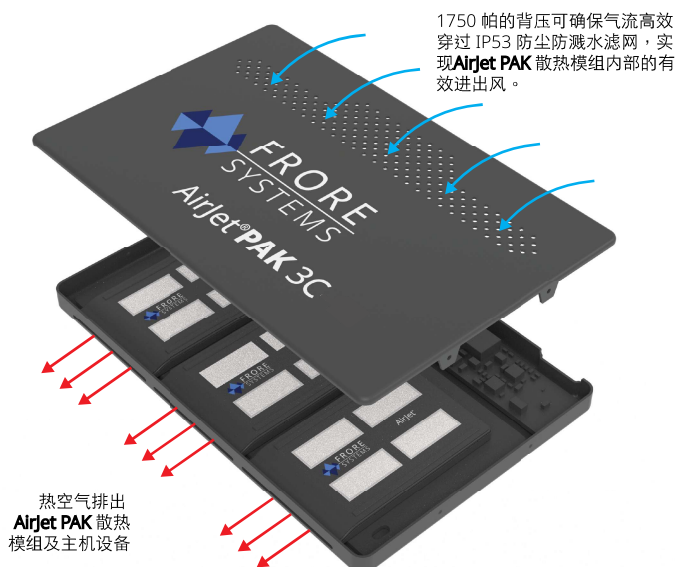
强劲散热能力 - AirJet PAK 3C 在 27 dBA 的静音状态下可实现 24W 净散热，最大功耗仅 4W。当集成到均热板温度为 90°C 的计算平台时，其性能优于紧凑型边缘 AI 设备中的风扇方案。

释放 AI 性能 - 专为搭配 NVIDIA Jetson Orin Nano/NX 模组设计，**AirJet PAK 3C** 厚度仅 6.5mm。这一超薄形态为制造商带来了新的可能：在更紧凑、静音、无振动、防尘防溅水的设备中，为客户提供更高性能。

NVIDIA Jetson	AirJet PAK	TOPS	Power
Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	AirJet PAK 3C	80	20 W
Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	2x AirJet PAK 3C	157	40 W

每个 AirJet PAK 1C 内置 1 枚 AirJet 芯片——这是
全球首款固态主动散热芯片。

参数	AirJet®PAK 3C
总净散热功率 (@ 环境温度 25°C、结温 115°C)	24 W
最大噪音 (50cm距离)	27 dBA
最大功耗	4 W
背压	1750 Pa
尺寸 (宽×长×厚)	100 x 65 x 6.5 mm
重量	67 g



AirJet® PAK 3C

持续性能与可靠性

AirJet PAK 可产生 1750 Pa 背压，即使通风口覆盖 IP53 防尘防溅水滤网，也能确保气流有效进出模块。这一设计最大化了可靠性，保障 AirJet PAK 的持续散热性能，进而实现防尘防溅水设备的持续高性能运行。

AirJet PAK 采用自主驱动，仅需主机设备提供标准电源，即可助力处理器实现卓越性能。

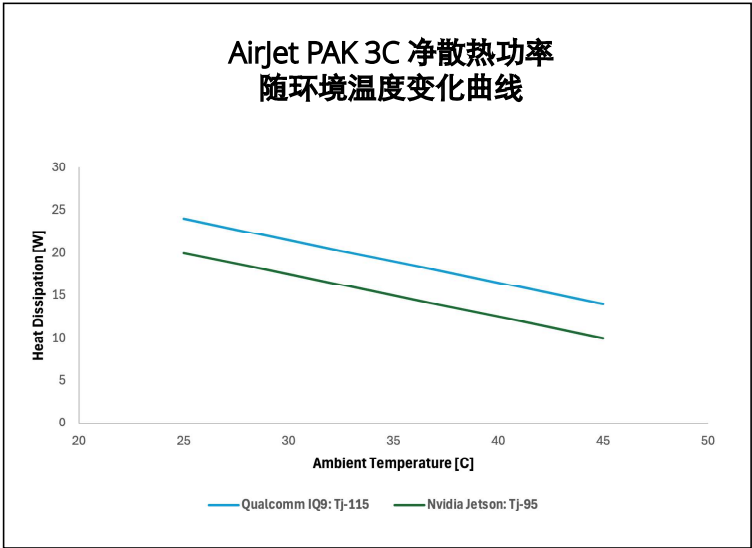
在如今的设备中，决定性能的往往是散热方案的能力，而非仅依赖处理器的先进性。

借助 AirJet PAK 3C，紧凑型边缘 AI 电子设备如今可兑现尖端 AI 技术的性能承诺。**实现更多。**



AirJet PAK 通过主机设备中应用板的 4 针 Molex PicoBlade 连接器供电

可与主机设备内的 NVIDIA Jetson Orin Nano 及 NX 模组无缝适配



AirJet® PAK 模块在主机设备内的横截面

